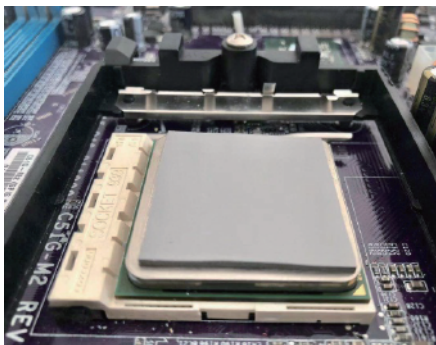


Fill-Pad US1000导热垫片

产品描述



导热垫片Fill-Pad US1000具有超软，低压力下高形变特性，其导热系数为10.0W/m-K。适用于需要多形变公差的应用，在填充不同尺寸的间隙的同时，产生非常微弱甚至可以忽略的回弹应力，最大程度地减小对精密电子器件的冲击。独特的配方设计使其具有良好的界面润湿性，导热性及优秀的力学特性，可适用于多种应用环境，不会因为压力和温度的波动而失效，此款垫片具有低挥发、低渗油性，尤其适用于对硅氧烷挥发物敏感的电子应用领域。

产品特点

- ◆ 导热系数10.0W/m-K
- ◆ 良好的表面润湿性可以充分降低接触热阻
- ◆ 较低压力产生较高形变量，弥补设计公差
- ◆ 低渗油
- ◆ 低挥发，D3-D10 (< 100ppm)

典型应用

- ◆ 5G通信基站、无线基础设施、光模块
- ◆ LCD、PDP和激光电视显示器
- ◆ 工业、LED照明及电源模块
- ◆ 汽车电子及动力电池
- ◆ 硬盘驱动器及固态硬盘存储设备
- ◆ 发热元器件与散热器或壳体之间散热

技术参数

性能参数	Fill-Pad US1000	测试方法
基本特性		
结构	陶瓷粉填充硅胶片	N/A
颜色	淡灰色	目视
厚度范围 (mm)	1.00 ~ 5.00	N/A
密度 (g/cm ³)	3.2	ASTM D792
硬度(Shore 00)	40	ASTM D2240
挥发物 TML (%)	0.35	ASTM E595
挥发物 CVCM (%)	0.05	ASTM E595
ΣD3-D10(硅氧烷含量PPM)	<100	GC-MS
工作温度(°C)	-40 ~ 125	泰吉诺实验室
导热性能		
导热系数 (W/m-K)	10.0	ASTM D5470
热阻 (°C·in ² /W) (1mm@10psi)	0.16	ASTM D5470
电学性能		
介电常数@ 1 MHz	5.5	ASTM D150
体积电阻率(ohm-cm)	2.0X10 ¹³	ASTM D257
阻燃等级		
阻燃等级	V-0	UL 94

注：本资料中数据皆为测试典型值，结果仅供参考，不可作为产品性能指标使用

注意事项

- ◆ 切勿食用
- ◆ 避开儿童可触及的地方保管
- ◆ 产品放置须远离火源
- ◆ 请确认使用的正确性之后再使用
- ◆ 注意不要让产品表面沾上异物和灰尘

保存及寿命

- ◆ 产品需在0-35°C，≤65%相对湿度环境下保存
- ◆ 保质期自包装之日起12个月

订购信息

- ◆ 厚度标称值±10%，厚度可以根据客户要求定制。订购前请详询可用厚度
- 背胶信息：A1代表单面加背胶

